



## 台積公司在美國、德國及新加坡對格羅方德提出 25 項專利侵權訴訟 以確保技術領先地位並保護其全球客戶與消費者

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2019 年 10 月 1 日

全球半導體製造領導創新者台積公司於 2019 年 9 月 30 日在美國、德國及新加坡三地對格羅方德（GlobalFoundries）提出多項法律訴訟，控告格羅方德侵犯台積公司 40 奈米、28 奈米、22 奈米、14 奈米、以及 12 奈米等製程之 25 項專利。台積公司在此訴訟之中要求法院核發禁制令，禁止格羅方德生產及銷售侵權之半導體產品，亦對非法使用台積公司半導體專利技術與銷售侵權產品之格羅方德尋求實質性的損害賠償。

訴訟中的 25 項台積公司專利涉及多種技術，包括 FinFET 設計、淺溝槽隔離技術、雙重曝光方法、先進密封環及閘極結構、以及創新的接觸蝕刻停止層設計，這些特定技術涵蓋了成熟及先進半導體製程技術的核心功能。有爭議的專利僅佔台積公司廣泛專利組合的一小部分，台積公司目前全球擁有超過 37,000 項專利，並在去年已連續三年成為全美前十大發明專利權人。

台積公司開創的專業積體電路製造服務商業模式，促成了規模達美金數千億元的美國無晶圓廠積體電路設計產業。此外，台積公司在全球半導體供應鏈的合作與發展上扮演關鍵的角色，舉例來說，台積公司與許多美國設備供應商、矽智財夥伴、以及電子設計自動化廠商攜手，在過去五年間，台積公司對美國供應商採購設備及服務的金額達約美金二百億元。同時台積公司亦與美國的客戶、供應商、以及頂尖大學緊密合作，驅動下一代半導體技術的發展。台積子公司在華盛頓州有生產基地，加州及德州皆設有辦公室，其員工人數超過千人。

台積公司副總經理暨法務長方淑華表示：「台積公司的專利反映了公司數十年來投入數百億資金進行研發的創新成果，對半導體製程技術的發展做出了重大的貢獻。台積公司此次提出法律訴訟為要保護我們的聲譽、龐大的投資、近 500 家客戶、以及全世界的消費者，以確保大家都能夠受惠於廣泛支援行動裝置、5G、人工智慧、物聯網、以及高效能運算等應用的最先進半導體技術，這些應用對於公共利益極為重要。」



## 關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，並一直是全球最大的專業積體電路製造服務公司。台積公司以業界先進的製程技術及設計解決方案組合支援一個蓬勃發展的客戶及夥伴的生態系統，以此釋放全球半導體產業的創新。

2019 年，台積公司全球總產能超過 1,200 萬片之十二吋晶圓約當量，台積公司並提供最廣泛的製程技術，全面涵蓋自（大於）0.5 微米製程至最先進的製程技術，即現今的 7 奈米製程。台積公司係首家提供 7 奈米製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司，其企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 [www.tsmc.com.tw](http://www.tsmc.com.tw) 查詢。

# # #

**台積公司發言人：**  
黃仁昭  
副總經理暨財務長  
Tel: 03-505-5901

**台積公司代理發言人：**  
孫又文  
企業訊息處資深處長  
Tel: 03-568-2085  
Mobile: 0988-937-999  
E-Mail: [elizabeth\\_sun@tsmc.com](mailto:elizabeth_sun@tsmc.com)